

## 專利權讓與公告：介電質材料形成平台側壁的半導體製造方法及其半導體元件 (US 9076650)

有鑑於在面對市場、技術、產品的激烈競爭時，企業掌握優質專利可形成強有力的防護網，並可藉此累積企業技術能力，成為企業在國際間競爭的最佳籌碼；國立中央大學擬將其所擁有之優質專利，以讓與方式提供國內廠商，以增加廠商國際競爭力及促進整體產業發展，並提昇研發成果運用效益。

|      |   |
|------|---|
| 公告主旨 | 專利權讓與遴選廠商公告：<br>介電質材料形成平台側壁的半導體製造方法及其半導體元件 (US 9076650)   |
| 公告時間 | 109 年 4 月 13 日  |
| 公告內容 | 一、 專利權家族名稱：<br>介電質材料形成平台側壁的半導體製造方法及其半導體元件 /<br>Method For Fabricating Mesa Sidewall With Spin Coated Dielectric Material<br>And Semiconductor Element Thereof<br>1. 美國專利證書號 US 9,076,650 (本校編號 101046US)<br>二、發明人：綦振瀛教授 (電機工程學系)、王聖瑜、紀駿邦<br>三、廠商資格：<br>1.產業類別：電子與光電工程-矽基半導體技術<br>2.應具備之專門技術：電子與光電工程<br>3.應有之機具設備：無<br>4.應有之研究或技術人員：電子與光電工程相關技術人員<br>5.其他條件：無特殊限制<br>6.其餘應符合本校技術移轉相關規定。<br>四、申請方式：逕向研發處智權技轉組詢問相關資訊，同時間有多間廠商申請時，以價高者優先。<br>五、申請截止日期：108 年 4 月 22 日 17 時 00 分止 |
| 聯絡人  | 研發處產學營運中心智權技轉組 鄭經理  |
| 聯絡電話 | 03-4227151 轉 27077  |
| 電子郵件 | johnny@g.ncu.edu.tw   |

### 專利摘要資料：

1. US 9076650：<http://ipm.ncu.edu.tw/prod1.asp?ser=17730>